

Title (en)

Assembly with at least one semiconductor module and a transport package

Title (de)

Anordnung mit mindestens einem Leistungshalbleitermodul und mit einer Transportverpackung

Title (fr)

Agencement doté d'au moins un module semi-conducteur de puissance et d'un emballage de transport

Publication

EP 2348804 A1 20110727 (DE)

Application

EP 10192495 A 20101125

Priority

DE 102010005048 A 20100120

Abstract (en)

The arrangement (1,1') has a transport packaging (2) which comprises a cover layer (10), an intermediate layer (20) with a recess (230), and a cover foil. The cover layer is formed with a main surface (100) in laminar manner, where the main surface faces a power semiconductor module (5). The cover foil covers a portion of the power semiconductor module. The cover foil is connected with a main surface (200) of the intermediate layer.

Abstract (de)

Die Anmeldung betrifft eine Anordnung mit mindestens einem Leistungshalbleitermodul und einer Transportverpackung, wobei das Leistungshalbleitermodul ein Bodenelement, ein Gehäuse und Anschlusselemente aufweist, und wobei die Transportverpackung eine Decklage, eine Zwischenlage mit jeweils einer dem mindestens einen Leistungshalbleitermodul zugeordneten Ausnehmungen und eine Deckfolie aufweist. Hierbei ist die Decklage flächig ausgebildet mit einer ersten dem anzuordnenden Leistungshalbleitermodul zugewandten Hauptfläche. Auf dieser ersten Hauptfläche der Decklage ist die Zwischenlage mit ihrer zweiten Hauptfläche angeordnet. In der mindestens einen Ausnehmungen auf der ersten Hauptfläche der Decklage ist das zugeordnete Leistungshalbleitermodul angeordnet, wobei dessen Bodenelement auf der ersten Hauptfläche der Decklage zu liegen kommt, und wobei die Deckfolie wesentliche Teile des Gehäuses des mindestens einen Leistungshalbleitermoduls anliegend überdeckt und wobei weiterhin die Deckfolie mit der ersten Hauptfläche der Zwischenlage verbunden ist.

IPC 8 full level

H05K 13/00 (2006.01); **B65D 75/32** (2006.01); **B65D 75/36** (2006.01)

CPC (source: EP KR US)

B65D 75/327 (2013.01 - EP KR US); **B65D 75/367** (2013.01 - EP KR US); **B65D 81/02** (2013.01 - KR); **B65D 85/30** (2013.01 - KR); **B65D 2575/3245** (2013.01 - EP KR US); **B65D 2585/86** (2013.01 - KR)

Citation (applicant)

- DE 3909898 A1 19900927 - SEMIKRON ELEKTRONIK GMBH [DE]
- DE 19928368 A1 19991223 - HAWERA PROBST GMBH [DE]

Citation (search report)

- [Y] US 6244442 B1 20010612 - INOUE ISAO [JP], et al
- [Y] US 5234105 A 19930810 - SATO SYOJI [JP], et al
- [Y] CA 2264339 A1 19990526 - DISPILL INC [CA]
- [A] US 2003019784 A1 20030130 - PYLANT JOHN D [US]

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

EP 2348804 A1 20110727; **EP 2348804 B1 20130619**; CN 102145795 A 20110810; CN 102145795 B 20150819; DE 102010005048 A1 20110721; JP 2011148555 A 20110804; JP 5732260 B2 20150610; KR 101784518 B1 20171011; KR 20110085870 A 20110727; US 2011203967 A1 20110825; US 8405195 B2 20130326

DOCDB simple family (application)

EP 10192495 A 20101125; CN 201110025019 A 20110120; DE 102010005048 A 20100120; JP 2011005745 A 20110114; KR 20100137809 A 20101229; US 201113010637 A 20110120